



(43) 國際公開日  
2005 年 4 月 28 日 (28.04.2005)

**PCT**

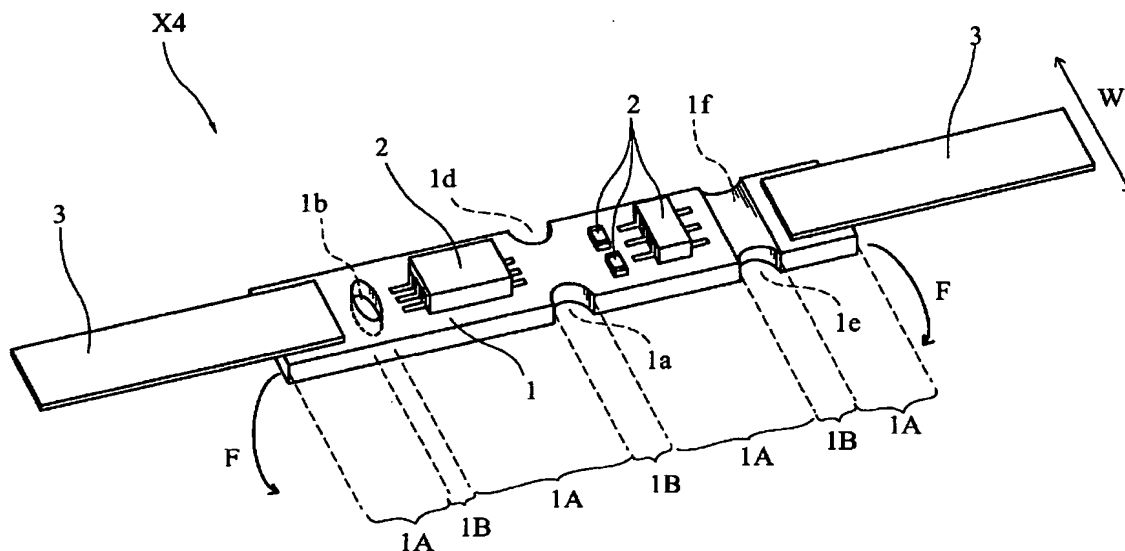
(10) 国際公開番号  
**WO 2005/039257 A1**

- |  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| (51) 国際特許分類 <sup>7</sup> :   | H05K 1/02                        | (72) 発明者; および   |
| (21) 国際出願番号:   | PCT/JP2004/015355                | (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田中 直也 (TANAKA, Naoya) [JP/JP]; 〒6158585 京都府京都市右京区西院溝崎町 2 1 番地 ローム株式会社内 Kyoto (JP).   |
| (22) 国際出願日:  | 2004 年 10 月 18 日 (18.10.2004)    | (74) 代理人: 吉田 稔, 外 (YOSHIDA, Minoru et al.); 〒5430014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町 2 番 3 2-1 3 0 1 Osaka (JP).   |
| (25) 国際出願の言語:  | 日本語                              | (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, |
| (26) 国際公開の言語:  | 日本語                              |   |
| (30) 優先権データ:<br>特願 2003-360173   | 2003 年 10 月 21 日 (21.10.2003) JP |   |
| (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ローム株式会社 (ROHM CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6158585 京都府京都市右京区西院溝崎町 2 1 番地 Kyoto (JP). |                                  |   |
- / 続葉有

〔続葉有〕

**(54) Title:** CIRCUIT BOARD

(54) 発明の名称: 回路基板



**(S7) Abstract:** The circuit board (X4) according to this invention includes a board main body (1) having a width, and electronic parts (2). The board main body (1) includes first regions (1A) whose cross section crossing the board main body (1) in a width direction (W) has a relatively large area, and second regions (1B) whose cross section crossing the board main body (1) in the width direction (W) has a relatively small area. The electronic parts (2) are packaged in the first regions (1A) of the board main body (1). Preferably, the board main body (1) is formed with notches (1a, 1d, 1e) which partly reduce the width of the board main body (1). Preferably, the board main body (1) is formed with a hole (1b) extending through the board main body (1). Preferably, the board main body (1) is formed with a groove (1f) which partly reduces the thickness of the board main body (1).

(57) 要約: 本発明の回路基板 (X4) は、幅を有する基板本体 (1) および電子部品 (2) を備える。基板本体 (1) は、当該基板本体 (1) を幅方向 (W) に横切る断面の面積が相対的に大きい第 1 部位 (1A) と、当該基板本体 (1) を幅方向 (W) に横切る断面の面積が相対的に小さい第 2 部位 (1

〔続葉有〕

**WO 2005/039257 A1**



NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

B)とを有する。電子部品(2)は、第1部位(1A)にて基板本体(1)に実装されている。好ましくは、基板本体(1)には、当該基板本体(1)の幅を部分的に小さくする切り欠き部(1a, 1d, 1e)が形成されている。好ましくは、基板本体(1)には、当該基板本体(1)を貫通する孔部(1b)が形成されている。好ましくは、基板本体(1)には、当該基板本体(1)の厚みを部分的に小さくする溝部(1f)が形成されている。